

Pâte thermique GD-3, 30 g, 7,5 W/m²K

Codes produits :

Référence AM6318

EAN13 : -

CUP : 38249996

caractéristiques du produit :

Couleur: Gris

Max. température de fonctionnement:
120 °C

Conductivité thermique: 7,5 W/mK



Attributs du produit :

Description du produit :

La pâte thermique GD-3 est conçue pour améliorer le transfert de chaleur entre les composants électroniques et les dissipateurs thermiques. Elle s'utilise lors de l'assemblage ou de la maintenance des processeurs, des GPU, des LED et autres composants nécessitant de combler les irrégularités microscopiques entre les surfaces de contact et de favoriser une dissipation thermique efficace. Son conditionnement en seringue permet un dosage précis lors de l'application.

Spécifications techniques

- Type de produit : pâte thermique
- Désignation : GD-3
- Conductivité thermique : 7,5 W/m K
- Couleur : gris
- Densité : 2,5 g/cm³
- Poids net : 30 g
- Température de fonctionnement : -35 à +120 °C
- Conditionnement : seringue

Fonctions et caractéristiques

- Elle sert à créer une interface thermoconductrice entre le composant et le dissipateur thermique.
- Contribue à réduire les espaces d'air entre les surfaces de contact.
- Le conditionnement en seringue facilite l'application de la quantité de produit requise.
- Convient pour une utilisation dans l'électronique et la gestion thermique des composants.

Idéal pour

- Processeurs et puces graphiques
- Modules LED et éclairage LED avec dissipateur thermique
- Service et maintenance des appareils électroniques refroidis
- Composants de montage sur radiateurs en aluminium

Contenu de l'emballage

- 1 tube de pâte thermique GD-3 en seringue, 30 g

Pourquoi choisir ce produit ?

- Conductivité thermique indiquée de 7,5 W/m·K pour une utilisation dans l'interface thermique des composants électroniques.
- La conception de la seringue permet une application plus propre et plus précise.
- Son poids de 30 g est adapté à une utilisation répétée lors du montage et de l'entretien.
- Conçu pour les applications nécessitant une amélioration du transfert de chaleur entre le composant et le dissipateur thermique.

Instructions d'installation et d'utilisation

- Nettoyer et dégraisser les deux surfaces de contact avant application.
- Appliquez uniquement une couche mince et continue en quantité nécessaire.
- Après application, assurez-vous d'exercer une pression mécanique adéquate du dissipateur thermique sur le composant.
- Évitez de contaminer la pâte avec de la poussière et des saletés.

Avis de sécurité

- Utilisez ce produit uniquement pour l'usage auquel il est destiné, dans le domaine du collage thermique de composants et de dissipateurs thermiques.
 - Lors de l'application sur des appareils électroniques, travaillez uniquement sur l'appareil éteint et débranché.
 - Éviter tout contact avec les yeux, la peau et l'intérieur des
-

connecteurs ou des contacts.

- Tenir hors de portée des enfants.

Galerie de produits :